

IIJ、通信機器内にソフトウェアのSIM機能を組み込む「SoftSIM」で、 携帯電話網を切り替えて通信できるマルチキャリア対応を開始

-- SoftSIMを活用したIoT製品の可用性向上、利用可能エリア拡大を実現 --

当社は、通信モジュール内にソフトウェアとして SIM 機能を組み込む「SoftSIM」において、携帯電話網を切り替えて通信できるマルチキャリア対応を開始いたします。「SoftSIM」は、当社がフル MVNO サービスを活かした IoT デバイス向けのソリューションとして 2019 年より提供しているものです。従来は、IIJ がフル MVNO として提供する NTTドコモ網のみで展開していましたが、このたびの機能拡張により、ローミングを活用しバックアップ回線として他事業者の携帯電話網も利用できるようになります。

本機能では、通信モジュール内に複数の通信事業者のプロファイル(携帯電話網に接続するための情報)を保持し、必要に応じて通信プロファイルを切り替えることが可能です。これにより、主回線としてドコモ網を利用し、携帯電話網の障害時や電波状況が不安定な場所での利用の際は、バックアップ回線へ自動的に切り替えるといった運用が可能になります。

当社はこれまで、マルチキャリア MVNO として、「IIJ モバイルサービス」における NTTドコモおよび KDDI 回線への対応、2 つのキャリアをまたいでデータ通信量を共有できるパケットシェアプラン、1 枚の物理 SIM で携帯電話網を切り替えて通信できる「マルチプロファイル SIM」など、複数キャリアを活用したサービスを提供してきました。また近年、IoT デバイスの分野では、機器の小型化や省電力化、故障率の低減を目的に、SoftSIM を選択するお客様が増え、SoftSIM を使った IoT ネットワークの信頼性向上や場所を選ばずシームレスに利用できることも求められています。こうした背景を踏まえ、SoftSIM においてもマルチキャリア対応を開始し、より高い可用性が必要な IoT ネットワークの構築を支援します。

■SoftSIM のメリット

物理 SIM が不要なことから、SIM カードやソケットなどの部品の製造・流通コストを大幅に削減することができます。また必要な部品点数が減ることにより IoT モジュールの小型化が可能であるのに加えて、製品の故障率の低減、温度や振動の耐性向上、防水性向上、SIM カードの盗難防止などの利点もあります。

■SoftSIM のマルチキャリア対応の概要

・柔軟な回線切り替えによる可用性向上

IoT デバイス側で所定のコマンドを実行することで、通信プロファイルを切り替えることが可能です。例えば、IoT ゲートウェイなどの端末に通信断を検知する仕組みを組み込むことで、人手を介さずにバックアップ回線への切り替えを行い、通信を継続することができます。

・IoT 製品、サービスの利用可能エリアの拡大

メイン回線(NTTドコモ網)の電波が不安定な環境においても、別キャリアの回線に切り替えてデータ通信が可能になります。これにより、IoT 機器の設置場所や電波のカバーエリアの制約を抑え、より幅広い環境で SoftSIM を使った IoT 製品やサービスを展開することが可能になります。

■利用イメージ



■参考価格

| | |
|----------------|--------------------|
| ・初期費用 | 3,000 円 |
| ・月額費用 | |
| メイン回線 月額基本料 | 200 円 |
| バックアップ回線 月額基本料 | 200 円 |
| 従量課金 | 15 円/MB(利用分に応じて課金) |

(※) 初期費用には通信モジュールの費用は含まれません。

(※) SoftSIM 完全従量制プラン 1 契約あたりの参考価格です。

(※) 表示価格はすべて税抜きです。

■IIJ の SIM ソリューション

SoftSIM は、IIJ の SIM ソリューションの一つとして提供しております。SoftSIM のより詳しい情報や対応しているモジュール、導入事例等については、ソリューション紹介ページをご覧ください。

IIJ モノづくり IoT ソリューション

https://www.ij.ad.jp/svcsol/campaign/mobile_202101.html

IIJ は今後も、フル MVNO およびマルチキャリアに対応する MVNO としての強みを生かし、IoT 分野における新たなサービスを積極的に展開するとともに、さまざまなお客様のビジネスを支援してまいります。

■展示会「JAPAN IT Week 組込み・エッジ・IoT 開発 EXPO」出展

当社は、2026 年 4 月 8 日より開催される JAPAN IT Week 組込み・エッジ・IoT 開発 EXPO に出展します。IoT やモノづくり向けのモバイルサービス、組み込み用 SIM の取り組みなどをご紹介します。

| | |
|-----------|---|
| 展示会名 | JAPAN IT Week 組込み・エッジ・IoT 開発 EXPO |
| 会期 | 2026 年 4 月 8 日(水)～10 日(金) 10:00～17:00 |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| ブース番号 | 西 4 ホール W24-5 |
| IIJ の展示概要 | IoT やモノづくり向けモバイルサービス、組み込み用 SIM ・SoftSIM (マルチキャリア対応) ・マルチプロファイル SIM 2.0 ・マルチプロファイル SIM 2.0 対応予定端末 (IoT ゲートウェイ、USB ドングル等) ・IIJ モバイルサービスの採用事例 ・SGP.32 等 |
| 詳細 | IIJ イベント・セミナー紹介ページからご確認ください。 https://www.ij.ad.jp/svcsol/seminar/ |

報道関係お問い合わせ先

株式会社インターネットイニシアティブ 広報部 中島、荒井

TEL : 03-5205-6310 FAX : 03-5205-6377

E-mail : press@ij.ad.jp URL: <https://www.ij.ad.jp/>

※本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録商標です。